

Plaskon MUF-2A LAR

Еpoxy; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is an epoxy molding compound for high temperature, lead-free reflow in low alpha applications. It is designed to withstand more demanding requirements in moisture performance, occasioned by the higher IR reflow temperatures required for processing lead-free packages. It is a highly filled, hybrid resin developed to pass JEDEC Level 2A at 260°C IR reflow temperature. It is a "green" compound with no halogens and a lower Tg than multifunctional materials.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Низкий уровень защиты Обрабатываемость, хорошая		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.89	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.050	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
22°C	1.77	MPa	ASTM D790
215°C	0.588	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
22°C	0.00834	MPa	ASTM D790
215°C	0.00343	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	195	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.6E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.75	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	4.5E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	31	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	3.13		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	1.7E-3		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Дополнительная информация			

Recommended Storage Temperature: <5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 5 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 150 cm Shimadzu Viscosity, 175°C, 1000 psi: 40 poise Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 16 sec Ash Content: 80 % Hydrolyzable Halides: <1 ppm Alpha Particle Count: <0.0015 counts/cm²/hr Cull Hot Hardness, Shore D: 85 All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 16 cm⁻⁶/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 55 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 165 to 170°C

Molding Pressure: 500 to 900 psi

In Mold Cure Time: 100 to 200 sec

Perform Temperature: 80 to 85°C

Transfer Time: 6 to 15 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat